【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】令和2年10月1日(2020.10.1)

【公開番号】特開2019-98691(P2019-98691A)
【公開日】令和1年6月24日(2019.6.24)
【年通号数】公開・登録公報2019-024
【出願番号】特願2017-234881(P2017-234881)
【国際特許分類】
Ｂ２９Ｃ　45/16　(2006.01)
Ｂ２９Ｃ　45/56　(2006.01)
Ｂ２９Ｃ　45/26　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ２９Ｃ　45/16
Ｂ２９Ｃ　45/56
Ｂ２９Ｃ　45/26

【手続補正書】
【提出日】令和2年8月18日(2020.8.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態に係る樹脂成形品を概略的に示す斜視図である。
【図２】図１のＡ－Ａ′線に沿った断面を概略的に示す断面図である。
【図３】ステッチ状意匠及びその近傍の意匠面の形状の一例を示す概略平面図である。
【図４】図３のＢ－Ｂ′線に沿った概略断面図である。
【図５】図３のＣ－Ｃ′線に沿った概略断面図である。
【図６】本実施形態に係る樹脂成形品の成形方法の一例を示す工程図である。図６（ａ）は、共通金型及び第１金型の型開き状態を示し、図６（ｂ）は、一次射出充填工程を示し、図６（ｃ）は、微小型開き工程を示し、図６（ｄ）は、共通金型と対向する金型を第１金型から第２金型に切り替えた状態を示し、図６（ｅ）は、二次成形工程を示している。
【図７】本実施形態に係る樹脂成形品の成形方法の他の例を示す工程図である。図７（ａ）は、射出成形用金型の型開き状態を示し、図７（ｂ）は、一次成形工程を示し、図７（ｃ）は、二次成形工程を示している。
【図８】特許文献１の樹脂成形品の成形方法を示す工程図である。図８（ａ）は、共通金型及び第１金型の型締め状態を示し、図８（ｂ）は、一次成形工程を示し、図８（ｃ）は、型開き工程を示し、図８（ｄ）は、共通金型と対向する金型を第１金型から第２金型に切り替えた状態を示し、図８（ｅ）は、共通金型及び第２金型の型締め状態を示し、図８（ｆ）は、二次成形工程を示し、図８（ｇ）は、成形された樹脂成形品を示している。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
図６及び図７に示したような、表層側成形体１０を成形してから基材層側成形体２０を積層成形させる方法では、図８に示したような、基材層側成形体２０を成形してから表層

側成形体１０を積層成形させる方法のように、基材層側成形体２０のステッチ部２４の突出端部（ステッチ状意匠２６）と第２金型５０の成形面とを噛み合わせて、その間に樹脂材料を浸入させないようなシールを構成する必要はない。また、ステッチ部２４が細く小さい場合であっても、先に形成された表層側成形体１０の貫通孔部１２を介して、凹部４０ａ，６０ａに基材層用樹脂が充填されるため、特許文献１の成形方法のように、ステッチ部２４が樹脂熱による再溶融（溶損）で消失したり、樹脂流動力による形状変形や位置ズレが生じたりするおそれがない。さらに、金型キャビティより熱伝導率が低い樹脂（表層用樹脂）で形成される貫通孔部１２の樹脂流路としての断熱性や保温性は、ステッチ部全体を金型キャビティで形成させる特許文献１に対して高い。そのため、二次成形工程での射出充填において、ステッチ状意匠２６が成形される凹部４０ａ，６０ａへの基材層用樹脂の樹脂充填性に優れると共に、凹部４０ａ，６０ａ内の基材層用樹脂への射出充填圧力及び保圧力の伝播性にも優れるため、詳細なステッチ状意匠２６の成形に好適である。